

SKYCOP® 焦铜电镀工艺

一、优点:

- 1、低电流密度区和广泛的电流密度范围均可得到均一镀层。
- 2、杂质容忍度特高，镀层不易起针孔，麻点，白雾。
- 3、操作简单，维护方便；材料来源广泛，成本较低。

二、开缸方法:

范 围

标 准

焦磷酸钾	200-240g/L	220g/L
焦磷酸铜	40-50g/L	45 g/L
氨水	1~3ml/L	2ml/L
温度	35-45℃	40℃
PH	8.3-9.0	8.5
阴极电流密度	1.0-6A/d m ²	
阳极电流密度	1.5-3A/ d m ²	
阳极	电解铜板	
搅拌	阴极移动或空气搅拌	
电压	2-10V	

三、溶液的配制:

- 1、在备用槽内加入 1/2 的纯水加热到 40 度。
- 2、加入计算量的焦磷酸钾溶解后加入焦磷酸铜直至完全溶解。
- 2、加入 2g/L 活性炭，搅拌一个小时，静置后过滤机过滤溶液到镀槽内。
- 3、加入 0.5ml/L 的双氧水，加入前先以水稀释，搅拌打气两小时。
- 4、用稀硫酸将 PH 调到 8.4。
- 5、用小电流将镀液电解 3-5 小时。
- 6、加入 2ml/L 的氨水，开始试镀。

氨水的消耗量约为：0.05—0.1ml/L/小时。

声明：此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数，是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性，故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。